合肥颀中科技股份有限公司

公司代码：688352　　公司简称：颀中科技

2024 年度 报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基准向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本118,903.7288万股，以此计算合计拟派发现金红利59,451,864.40元（含税）。2024年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司2024年度利润分配预案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司已于2024年11月22日完成2024年前三季度现金红利派发59,451,864.40元（含税）。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	颀中科技	688352	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余成强	陈颖/龚玉娇
联系地址	江苏省苏州市工业园区凤里街166号	江苏省苏州市工业园区凤里街166号
电话	0512-88185678	0512-88185678
传真	0512-62531071	0512-62531071
电子信箱	irsm@chipmore.com.cn	irsm@chipmore.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司自设立以来，一直从事集成电路的先进封装和测试服务。公司秉持"以技术创新为核心驱动力"的研发理念，通过近二十年的研发积累和技术攻关，在凸块制造、测试以及后段封装环节上掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术和大量工艺经验，相关技术适用于显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等不同种类的产品，可以满足客户高性能、高品质、高可靠性封装测试需求。

在集成电路凸块制造领域，公司以金凸块为起点相继研发出"微细间距金凸块高可靠性制造技术"、"大尺寸高平坦化电镀技术"等核心技术，在提高预制图形高结合力、提升电镀环节稳定性等方面具有核心竞争力。近年来，公司的研发创新不局限于原有的金凸块上，在铜柱凸块、铜镍金凸块、锡凸块等其他凸块制造方面也取得了行业领先的研发成果。以铜镍金凸块为例，公司是目前境内少数可大规模量产铜镍金凸块的企业，开发出了"低应力凸块下金属层技术"、"微间距线圈环绕凸块制造技术"、"显示驱动芯片铜镍金凸块制造技术"、"高介电层加工技术"等核心技术，可在较低成本下有效提升电源管理芯片等产品的性能。同时扩展了铜镍金凸块的应用，开发出了"显示驱动芯片铜镍金凸块制造技术"，在满足此类市场需求的同时实现了成本的有效控制，为显示驱动芯片封装提供了新的技术选择。

在集成电路测试领域，公司自主开发的"测试核心配件设计技术"和"集成电路测试自动化系统"形成了完整的测试解决方案。这套系统不仅能满足不同客户的个性化测试需求，还实现了测试过程的高度自动化，大幅提升了测试效率和准确性。

在集成电路封装领域，公司以COF、COG/COP等显示驱动芯片封装技术为抓手，拥有"高精度高密度内引脚接合"、"125mm大版面覆晶封装"、"全方位高效能散热解决技术"、"高稳定性晶圆研磨切割"等关键技术。针对非显示类芯片的封装工艺，可同时提供后段的DPS和载板覆晶封装服务，助力实现更小尺寸和更高集成度的整套封装测试的解决方案，有助于进一步增强公司的技术领先优势，并拓宽服务领域至如高性能计算、数据中心、自动驾驶等尖端市场，争取在国际竞争中占据有利地位，公司相继研发出"高精高稳定性新型半导体材料晶圆切割技术"" 高精密覆晶方形扁平无引脚及模块之封测的技术研究"，在可切割晶圆的精度、厚度、材质等方面进行了创新，尤其是面对半导体材料种类的不断丰富，如钽酸锂（LiTaO3）、硅锗（SiGe）、铌酸锂（LiNbO3）等，公司皆有显著成果。

2.2 主要经营模式

就集成电路封装测试行业而言，目前行业内主要存在IDM公司以及专业封装测试公司（OSAT）两类。基于技术优势、下游产品、客户群体、产业链配置等因素，相较于集芯片设计、制造、封测等多个产业链环节于一身的IDM模式，公司专注于集成电路产业链中的先进封装测试服务。报告期内，公司主要经营模式保持稳定，未发生重大变化。影响公司经营模式的关键因素主要在于产业政策的变化或推进、市场竞争情况变化、行业发展趋势、前沿产品技术的发展与应用等。未来，公司将积极巩固现有业务优势，把握市场、技术等方面的发展前瞻，实现市场竞争力的稳固与加强。

（1）盈利模式

公司主要从事集成电路的先进封装测试，可为客户提供定制化的整体封测技术解决方案，处于半导体产业链的中下游。作为专业的封装测试企业（OSAT），公司采用集成电路封装测试行业通用的经营方式，即由IC设计公司（Fabless）委托晶圆代工企业（Foundry）将制作完成的晶圆运送至公司，公司按照与IC设计公司约定的技术标准设计封测方案，并对晶圆进行凸块制造、测试和后段封装等工序，再交由客户指定的下游厂商以完成终端产品的后续加工制造。公司主要通过提供封装与测试服务获取收入和利润。

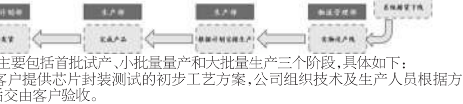
（2）采购模式

公司设置采购部，统筹负责公司的采购事宜。根据实际生产需要，采购部按生产计划采购金盐、靶材、光阻液等原材料以及其他各类辅料，并负责对生产设备及配套零部件进行采购。针对部分价格波动较大且采购量较大的原材料（如金盐等），在实际需求的基础之上，公司会根据大宗商品价格走势择机采购以控制采购成本。由需求部门提出采购需求，经审核后产生请购单，采购部进行询价、比价和议价流程，通过综合选比后确定并生成采购订单。供应商根据采购订单进行供货，采购部进行交期追踪及请款作业。公司建立了《供应商管理办法》等供应商管理体系，每个季度定期对供应商进行考核，并对品质、交期和配合度三大指标进行考核并量化评分。

（3）生产模式

公司建立了一套完整的生产管理体系，由于封测企业需针对客户的不同产品安排定制化生产，因此公司主要采用"以销定产"的生产模式。公司下设制造中心、研发中心与品保本部负责生产与产品质量管控。

生产流程方面，根据客户订单及销售预测，公司生产部门制定每月生产计划，并根据实际生产情况进行动态调整。待加工的晶圆入库后，生产部门同步在MES系统中进行排产，后根据作业计划进行生产。待产品生产完成后，根据客户指示安排物流运输。



公司生产流程主要包括首批试产、小批量量产和大批量生产三个阶段，具体如下：

①首批试产：客户提供芯片封装测试的初步工艺方案，公司组织技术及生产人员根据方案进行试产，完成样品生产后交由客户验收。

②小批量量产：首批试产后的样品经客户验证，如满足相关技术指标的要求且封装的产品符合市场需求，则进入小批量量产阶段。此阶段，公司着重进行生产工艺、产品良率的提升。

③大批量生产：在大批量生产阶段，生产计划部门根据客户订单需求安排生产、跟踪生产进度并向客户提供生产进度报告。此阶段，公司需保障产品具有较高的可靠性和良率水平，并具备较强的交付能力。

（4）销售模式

公司下设行销中心，包括显示行销本部、非显示行销本部与客户服务部三大部门，并在中国台湾设立办事处负责当地客户的开发和维护。公司销售环节均采用直销的模式。公司主要通过主动开发、客户引荐等方式获取新的客户资源。

（5）研发模式

公司主要采用自主研发模式，公司以市场和客户为导向，坚持突破创新，不断发展先进产品封测技术，并设立专业的研发组织及完善的研发管理制度。公司研发流程主要包括立项、设计、工程试作、项目验收、成果转化5个阶段。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）所处行业

公司的主营业务为集成电路的封装测试，根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）下属的集成电路制造业（C3973），具体细分行业为集成电路封装测试业。

公司是集成电路高端先进封装测试服务商，可为客户提供全方位的集成电路封测综合服务，覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等多类产品。公司在以凸块制造（Bumping）和覆晶封装（FC）为核心的先进封装技术上积累了丰富经验并保持行业领先地位，是境内少数掌握多类凸块制造技术并实现规模化量产的集成电路封测厂商，也是境内最早专业从事8吋及12吋显示驱动芯片全制程（Turn-key）封测服务的企业之一。

（2）行业发展阶段及基本特点

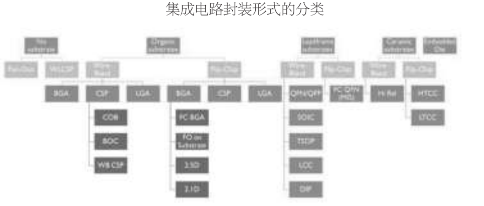
集成电路封测是集成电路产品制造的后道工序，指将通过测试的晶圆按产品型号及功能需求加工得到独立集成电路的过程，具体包含封装与测试两个主要环节。

集成电路封装是指将集成电路与引脚相连接以达到连接电信号的目的，并使用塑料、金属、陶瓷、玻璃等材料制作外壳保护集成电路免受外部环境的损伤。集成电路封装不仅起到集成电路芯片内键合点与外部进行电气连接的作用，也为集成电路提供了一个稳定可靠的工作环境，使集成电路能够发挥正常的功能，并保证其具有高稳定性和可靠性。

集成电路测试包括进入封装前的晶圆测试（CP）以及封装完成后的成品测试（FT），晶圆测试主要是在晶圆层面上检验每个晶粒的电性，成品测试主要检验切割后产品的电性和功能，目的是在于将有结构缺陷以及功能、性能不符合要求的芯片筛选出来。

由于不同集成电路产品电性能、尺寸、应用场景等因素各不相同，因此造成封装形式多样复杂。根据是否具有封装基板以及封装基板的材质，集成电路封装产品可以分为四大类，即陶瓷基板产品、引线框架基板产品、有机基板产品和无基板产品。其中陶瓷基板产品、引线框架基板产品和有机基板产品都可以分为倒装封装和引线键合封装两种方式，而无基板产品又可具体分为扇出型封装（Fan-out）和扇入型晶圆级芯片尺寸封装（Fan-in WLCSP）两类。

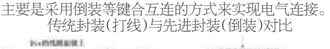
集成电路封装形式的分类



数据来源：YoleDéveloppement

在业内，先进封装技术与传统封装技术主要以是否采用焊线（即引线焊接）来区分，传统封装一般利用引线框架作为载体，采用引线键合互连的形式进行封装，即通过引出金属线实现芯片与外部电子元器件的电气连接；而先进封装主要是采用倒装等键合互连的方式来实现电气连接。

传统封装（打线）与先进封装（倒装）对比



（3）主要技术门槛

公司所处的先进封测行业，具有较高的技术门槛和难点，需要企业在技术创新、设备投入、人才培养和产业链合作等方面进行持续的努力。①如金凸块制造环节具有溅镀、黄光（光刻）、蚀刻、电镀等多道环节，需要在单片晶圆表面制作数百万个极其微小的金凸块作为芯片封装的引脚，并且对凸块制造的精度、可靠性、微细间距均有较高的要求，因而目前中国大陆具备凸块制造能力的封测企业较少；②铜柱凸块、铜镍金凸块、锡凸块制造环节都具有再钝化层制作、溅镀、黄光（光刻）、多次电镀、蚀刻等多道环节，需要在单片晶圆表面数万颗芯片内实现多次电镀、微间距线圈环绕、高介电层隔离、多层堆叠等技术。以铜镍金凸块为例，芯片覆铜比例大，大面积的覆铜通常会产生较高的应力，对芯片产生破坏，而应力释放就需要从种子层的材料、厚度、工艺控制，以及钝化层的材料、厚度、设计等各方面进行控制，另外对于多次电镀层高度的均匀性要求、微间距线圈宽度和间距的精准控制、多层结构各层间高度控制和层与层间的结合力都有着很高的要求；③显示驱动芯片对性能要求高，主要使用金凸块，但是金材料带来了高成本，铜镍金凸块制造技术不断突破创新，扩展了铜镍金凸块在显示驱动芯片的应用，实现了高精度、高可靠性、微细间距的技术水平，同时大幅降低了材料成本；④先进封装芯片的测试环节，需要具备全面的测试和验证流程，以确保芯片在各种工作条件下的性能和可靠性，这包括电气性能测试、信号完整性测试、不同温度环境下的性能测试等，测试技术需要不断更新以适应新的应用领域及环境，随着5G、物联网、人工智能等新兴技术的发展，先进封装测试技术的重要性将进一步凸显，成为推动半导体产业发展的关键因素；⑤在COF封装环节，由于显示驱动芯片I/O接点间距最小仅数微米，需要在几十毫秒内同时将数千颗I/O接点一次性精准、稳定、高效地进行结合，难度较大，需要配备专门的技术团队进行持续研发。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司自设立以来即定位于集成电路的先进封装业务，子公司苏州颀中成立于2004年，是境内最早实现显示驱动芯片全制程封测能力的企业之一。通过20年的辛勤耕耘，公司历经数个半导体行业周期，业务规模和技术水平不断壮大，在境内显示驱动芯片封测领域常年保持领先地位，同时在整个封测行业的知名度和影响力不断提升。2024年，公司显示驱动芯片封测业务销售量1,845,291.05千颗，营业收入17.58亿元，是境内收入规模最高的显示驱动芯片封测企业，在全球显示驱动芯片封测领域位列第三名。

在不断巩固显示驱动芯片封测领域优势地位的同时，公司逐渐将业务扩展至以电源管理芯片、射频前端芯片为主的非显示类芯片封测领域，持续延伸技术产品线，在新制程、新产品等领域不断发力，向价值链高端拓展，积极扩充公司业务版图，向综合类集成电路先进封测厂商迈进。2024年，公司非显示类芯片封测营业收入15,192.18万元，较去年同期增长16.98%。

多年来公司在产品质量、可靠性、专业服务等方面赢得了客户的高度认可，积累了联咏科技、敦泰电子、奇景光电、奕斯伟计算、瑞鼎科技、谱瑞科技、晶门科技、集创北方、矽力杰、杰华特、南芯半导体等境内外优质客户资源。

2024年公司持续深化研发创新，巩固细分领域市场优势，稳步推进产能提升，子公司苏州颀中荣获"江苏省省级企业技术中心"等荣誉称号。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

在摩尔定律放缓背景下，为寻求提升集成电路产品系统集成、高速、高频、三维、超细节距互连等特征，提升芯片集成密度和芯片内连接性能已成为当今集成电路产业的新趋势。先进封装技术能够在再布线层间距、封装垂直高度、I/O密度、芯片内电流通过距离等方面提供更多解决方案。封装环节对于提升芯片整体性能愈发重要，行业内先后出现了Bumping、FC、WLCSP、2.5D、3D等先进封装技术，先进封装已经成为后摩尔时代的重要途径。

随着5G通信技术、物联网、大数据、人工智能、视觉识别、新能源汽车、自动驾驶等新兴应用场景的快速发展，为集成电路产业发展带来巨大的机会，同时新兴应用市场对集成电路多样化和复杂程度的要求越来越高，并且原有终端设备的结构调整为集成电路产业带来新的增长动力。如4k及8k高清电视占比的提升促进了显示驱动芯片需求数量的增加，又如5G时代的到来推动了射频前端芯片需求量不断提升，技术变革和新兴下游市场的需求变革为集成电路产业提供了巨大增长动力。同时得益于各大面板厂如京东方、维信诺、天马等对AMOLED的持续布局，AMOLED渗透率不断增长。根据CINNO Research数据显示，2024年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约8.8亿片，同比增长27.0%，另根据Omdia预估，AMOLED智能手机的需求将持续增长。随着其他应用的提升，AMOLED显示驱动芯片市场在2028年前将保持双位数的增长。同时国内AMOLED产能的持续释放及其向低阶产品市场的不断渗透，也成为了推动市场发展的关键因素。

近年来，随着中国大陆电子制造业快速发展，国家对集成电路产业重视程度不断提升，推出了一系列法规和产业政策推动行业的发展，同时在税务、技术、人才等多方面提供了有利支持。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	6,991,013,658.68	7,153,333,609.63	-2.27	4,823,070,377.17
归属于上市公司股东的净资产	6,003,292,022.20	5,830,126,768.94	2.97	3,223,245,057.27
营业收入	1,959,375,628.33	1,629,340,035.50	20.26	1,317,063,145.81
归属于上市公司股东的净利润	313,276,970.57	371,662,508.64	-15.71	303,175,043.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,676,779.67	339,685,424.03	-18.55	271,122,714.05
经营活动产生的现金流量净额	690,346,690.70	541,275,168.61	27.54	701,403,791.26
加权平均净资产收益率(%)	5.29	7.59	减少2.30个百分点	9.88
基本每股收益(元／股)	0.26	0.33	-21.21	0.31
稀释每股收益(元／股)	0.26	0.33	-21.21	0.31
研发投入占营业收入的比例(%)	7.89	6.52	增加1.37个百分点	7.59

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	443,405,252.67	490,467,043.17	501,434,728.42	524,068,604.07
归属于上市公司股东的净利润	76,687,049.55	85,337,129.91	66,377,057.79	84,875,733.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	73,122,648.11	84,354,259.67	62,790,547.79	56,409,324.10
经营活动产生的现金流量净额	139,325,879.74	177,062,423.75	162,355,343.65	211,603,043.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,864
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,204
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
合肥颀中科技控股有限公司	0	397,127,159	33.40	397,127,159	无	0	国有法人
Chipmore Holding Company Limited	0	302,389,708	25.43	302,389,708	无	0	境外法人
合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	0	123,639,298	10.40	123,639,298	无	0	其他
CTC Investment Company Limited	-200	34,397,878	2.89		无		境外法人
南京盈志创业投资合伙企业（有限合伙）	-13,515,318	18,627,983	1.57		无		其他
张鸿飞	未知	11,037,000	0.93		无		境内自然人
中信证券股份有限公司－嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	8,935,300	10,243,970	0.86		无		其他
国华人寿保险股份有限公司－自有四号	0	8,264,462	0.7		无		其他
陈永正	未知	7,440,000	0.63		无		境内自然人
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	-300,504	6,372,075	0.54		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	合肥颀中科技控股有限公司和合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）是一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

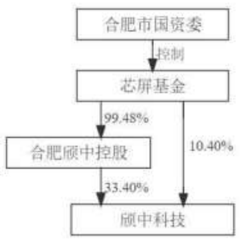
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

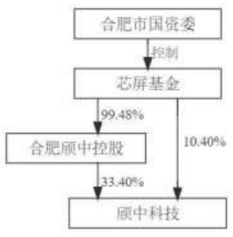
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入195,937.56万元，较上年同期增长20.26%；实现归属于上市公司股东的净利润31,327.70万元，较上年同期减少15.71%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润27,667.68万元，较上年同期减少18.55%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688352　　证券简称：颀中科技　　公告编号：2025-003

合肥颀中科技股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- ● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
- ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- ● 在实施权益分派的股权登记日前合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告披露。
- ● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为人民币1,245,294,774.33元，母公司报表未分配利润为人民币115,586,661.41元。经公司第二届董事会第三次会议决议，同意公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,189,037,288股，以此计算合计拟派发现金红利59,451,864.40元（含税）。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司于2024年11月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,189,037,288股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利59,451,864.40元。

综上，2024年度公司现金分红总额为118,903,728.80元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为37.95%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

单位：元　币种：人民币

项目	2024年度
现金分红总额	118,903,728.80
回购注销总额	0
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	313,276,970.57
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	115,586,661.41
最近三个会计年度累计现金分红总额(含税)(1)	118,903,728.80
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	313,276,970.57
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	118,903,728.80
最近三个会计年度现金分红比例(%)(5)=(3)/(4)	37.95
现金分红比例是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额(6)	154,686,627.28
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入(7)	1,959,375,628.33
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	7.89
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上(8)=(6)/(7)	否
是否触及《股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

注：最近三个会计年度年均净利润金额、最近三个会计年度累计研发投入金额、最近三个会计年度累计营业收入为2024年数据。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月31日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本预案符合《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年3月31日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，全体监事认为公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，2024年度利润分配预案是充分考虑了公司的盈利情况，结合公司未来资金需求等因素，兼顾公司战略、未来投资计划及股东利益，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意2024年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码：688352　　证券简称：颀中科技　　公告编号：2025-004

合肥颀中科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度 会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- ● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）。

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元（人民币，下同），审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户22家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目组成员	姓名	职业资质	从业经历
签字注册会计师（项目合伙人）	刘华凯	注册会计师	2009年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师	朱逸莲	注册会计师	2020年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计，2020年开始在天职国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
签字注册会计师	杨笑	注册会计师	2019年成为中国注册会计师，2019年开始在天职国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人	申旭	注册会计师	2016年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告3家。

2.诚信记录

项目合伙人兼签字注册会计师刘华凯、签字注册会计师朱逸莲及杨笑、项目质量控制复核人申旭近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度天职国际的审计报酬是150万元（含税），其中财务报告审计费用为125万元，内部控制审计费用为25万元，董事会提请股东大会授权管理层根据2025年公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬及签署相关协议文件。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见

公司董事会审计委员会对天职国际进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在过往执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量。2025年3月31日，公司第二届董事会审计委员会第二次会议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，一致同意续聘天职国际为公司2025年度财务及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事专门会议对续聘会计师事务所的审核意见

公司独立董事专门会议对续聘天职国际为公司2025年度财务及内部控制的审计机构进行了审查：认为天职国际具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计的工作需要。认为本次聘请的财务审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘天职国际为公司2025年度财务及内部控制的审计机构。并同意将该议案提交董事会审议。

（三）董事会和监事会的审议和表决情况

公司于2025年3月31日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2025年度财务及内部控制的审计机构。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码：688352　　证券简称：颀中科技　　公告编号：2025-011

合肥颀中科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体 承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"或"颀中科技"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设和前提条件

1、假设未来宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况等未发生重大不利变化。不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益、利息摊销等）的影响。

2、根据本次发行方案，公司拟发行合计不超过85,000.00万元（含本数）可转换公司债券，假设按照上限发行85,000.00万元，不考虑发行费用等影响。假设公司于2025年12月末完成本次可转债发行。本次可转债发行实际到账的募集资金规模及时间将根据监管部门审核及注册情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

3、本次向不特定对象发行可转换公司债券期限为6年，转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，则分别假设截至2026年6月30日全部转股或截至2026年12月31日全部未转股两种情形。该转股完成时间仅为估计，最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准。

4、公司2024年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为31,327.70万元和27,667.68万元。假设公司 2025年、2026年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润较上年持平、增长10%、增长20%进行测算（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。

5、假设不考虑本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率的数值预测。

6、假设本次可转换公司债券的转股价格为12.75元/股（该价格为本次董事会召开日，即2025年3月31日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，实际初始转股价格根据公司募集说明书公告日前二十个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定）。该转股价格为模拟测算价格，仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

7、假设以2024年底的股本总数为基数，除本次发行外，暂不考虑如股权激励、员工持股计划、现金/股票分红、增发及股票回购等其他会对公司股本产生影响或潜在影响的情形。

8、假设不考虑未来分红因素的影响。

9、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准。

10、在预测公司发行后归属于母公司股东的所有者权益时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

上述假设分析并不构成公司的盈利预测或分红承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对主要财务指标的影响

项目	2024年12月31日/2024年度	2025年12月31日/2025年度	2026年12月31日/2026年度	
			2026年末全部未转股	2026年6月30日全部转股
期末总股本(万股)	118,903.73	118,903.73	118,903.73	125,570.40
情形1：2025年度、2026年度实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年度持平				
归属于母公司所有者的净利润(万元)	31,327.70	31,327.70	31,327.70	31,327.70
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	27,667.68	27,667.68	27,667.68	27,667.68
基本每股收益(元/股)	0.26	0.26	0.26	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.26	0.25	0.25
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.23	0.23	0.23	0.23
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.23	0.23	0.22	0.22
假设2：假设公司2025年度、2026年度实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年度增长10%				
归属于母公司所有者的净利润(万元)	31,327.70	34,460.47	37,906.52	37,906.52
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	27,667.68	30,434.45	33,477.89	33,477.89
基本每股收益(元/股)	0.26	0.29	0.32	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.29	0.30	0.30
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.23	0.26	0.28	0.27
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.23	0.26	0.27	0.27
假设3：假设公司2025年度、2026年度实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年度增长20%				
归属于母公司所有者的净利润(万元)	31,327.70	37,593.24	45,111.89	45,111.89
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	27,667.68	33,201.22	39,841.46	39,841.46
基本每股收益(元/股)	0.26	0.32	0.38	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32	0.36	0.36
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.23	0.28	0.34	0.33
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.23	0.28	0.32	0.32

二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟投资项目将在可转换公司债券存续期内逐渐为公司带来经济效益，但存在不能实现预期收益的风险。

本次发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息，由于可转换公司债券票面利率一般较低，正常情况下公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息，不会摊薄每股收益。如果公司对可转换公司债券募集资金运用所带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券需支付的债券利息，则将使公司税后利润面临下降风险，将摊薄公司普通股股东即期回报。

投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例、公司每股收益等指标可能产生一定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次向不特定对象发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。

公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、本次发行的必要性与合理性分析

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）均经过公司谨慎论证，其实施具有必要性和可行性，将进一步优化公司产品结构，扩大业务规模，增强公司竞争力、盈利能力和可持续发展能力，具体分析详见公司同日披露的《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司是集成电路高端先进封装测试服务商，可为客户提供全方位的集成电路封测综合服务，覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等多类产品。凭借在集成电路先进封装行业多年的耕耘，公司在以凸块制造（Bumping）和覆晶封装（FC）为核心的先进封装技术上积累了丰富经验并保持行业领先地位，形成了以显示驱动芯片封测业务为主，电源管理芯片、射频前端芯片等非显示类芯片封测业务齐头并进的良好格局。

公司本次募集资金投资项目是基于现有主营业务基础上，在扩充现有制程产品产能的同时，显示驱动芯片封测业务将新增铜镍金凸块工艺在显示驱动芯片封装中的应用，以满足在金价持续上涨的背景下，市场对更具性价比的封装解决方案的需求；非显示类芯片封测业务将新导入BGBM/FSM、Cu Clip、FC制程，构建起完善的全制程封测技术体系，提升公司在非显示类芯片封测领域的市场竞争实力，为后续业务的进一步拓展与市场份额的提升奠定了坚实基础。

五、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司从事本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况详见公司同日公告的《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，增强公司持续回报能力。公司填补即期回报的具体措施如下：

（一）持续完善公司治理、提升公司经营管理水平

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。

（二）稳健推进募投项目建设，提升持续盈利能力

本次募投项目均围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行业发展趋势，其顺利实施将增强公司的盈利能力及核心竞争实力，优化公司的资本结构，提升公司的影响力。

本次募集资金到位前，公司将积极调配资源，充分做好募投项目开展的筹备工作；募集资金到位后，公司将提高资金使用效率，稳健推进募投项目的实施，争取募投项目早日实现预期效益，从而提高公司的盈利水平，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险，维护全体股东的长远利益。

（三）加强募集资金管理，确保募集资金规范有效使用

本次发行的募集资金到位后，公司将严格执行《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及公司募集资金管理办法的要求，规范募集资金使用，保证募集资金充分有效利用。

公司董事会将持续对募集资金进行专户存储、保障募集资金用于规定的用途、配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

（四）进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策，优化投资回报机制

公司根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制订了《合肥颀中科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，进一步明晰和稳定对股东的利润分配，特别是现金分红的回报机制。本次发行完成后，公司将严格执行公司的分红政策，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

七、相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关要求，为维护广大投资者的利益，公司就本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：

（一）控股股东承诺

公司控股股东合肥颀中控股对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施事宜，郑重作出以下承诺：

"一、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

二、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

三、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。"

（二）董事、高级管理人员承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重作出以下承诺：

"一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

四、本人承诺由董事会或提名、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

五、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

六、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

七、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。"

八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司已于2025年3月31日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，会议审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》，独立董事专门会议已就该事项做出明确同意的决议，上述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码：688352　　证券简称：颀中科技　　公告编号：2025-012

合肥颀中科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换 公司债券预案披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码：688352　　证券简称：颀中科技　　公告编号：2025-013

合肥颀中科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- ● 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则解释及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。
- ● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2023年10月，财政部颁发了《企业会计准则解释第17号》，对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明确，该解释自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部颁发了《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

二、变更前后采用的会计政策

（一）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司自2024年1月1日起将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》执行；公司自2024年12月6日起按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部颁发的企业会计准则解释及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码：688352　　证券简称：颀中科技　　公告编号：2025-014

合肥颀中科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通知于2025年3月21日以通讯和邮件方式发出，于2025年3月31日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于〈合肥颀中科技股份有限公司2024年年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司2024年年度报告》及《合肥颀中科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（二）会议审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：报告期内，公司实现营业收入195,937.56万元，较上年同期增长20.26%；实现归属于上市公司股东的净利润31,327.70万元，较上年同期减少15.71%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润27,667.68万元，较上年同期减少18.55%。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议及第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本1,189,037,288股，以此计算合计拟派发现金红利59,451,864.40元。2024年度公司现金分红总额为118,903,728.80元（含2024年前三季度已派发现金红利59,451,864.40元），占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为37.95%。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第二次会议及第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-003）。

（四）会议审议通过了《关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《合肥颀中科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定2025年中期分红安排，为简化分红程序，公司董事会提请股东大会批准，授权董事会在符合2025年中期利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本议案已经公司第二届独立董事专门会议第二次会议及第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）会议审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议审议通过了《关于评估独立董事独立性情况的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事崔也光先生、独立董事王新先生、独立董事胡晓林先生回避表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（八）会议审议通过了《关于公司〈2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议及第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

（九）会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常生产经营的情况下，公司及全资子公司颀中科技（苏州）有限公司拟利用暂时闲置的资金择机购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品，盘活资金，提高收益。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议及第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。

（十）会议审议通过了《关于公司2025年远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于公司2025年远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-005）。

（十一）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本次公司及全资子公司颀中科技（苏州）有限公司向银行申请综合授信额度是在综合考虑公司及子公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议及第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）会议审议通过了《关于向中国银行申请固定资产贷款授信额度的议案》

本次公司全资子公司颀中科技（苏州）有限公司基于"高精度显示驱动芯片封装及测试改造项目"建设需要，向中国银行合肥庐阳支行申请固定资产贷款授信额度是在综合考虑子公司业务发展的实际需要后做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议及第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（下转B134版）